

证券代码：300689

证券简称：澄天伟业

编号：2025-006

深圳市澄天伟业科技股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称/人员姓名	国泰海通、玖稳资产、衍进资产
时间	2025年6月18日
地点	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B座34楼公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事：宋嘉斌 董事会秘书、财务总监：蒋伟红 证券事务代表：陈远紫
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司介绍公司基本情况和发展历程。</p> <p>二、与调研机构的互动交流。</p> <p>公司与调研机构方互动交流的主要内容如下：</p> <p>Q1、2025年一季度业绩高增长的具体原因？</p> <p>答：增长原因如下：</p> <p>（1）持续加大智能卡产品销售力度，依托于行业内端到端的全产业链覆盖优势，多维度拓展国内外市场，收入同比增长；</p> <p>（2）已实现半导体封装材料的自主设计与量产落地，产品可覆盖MOSFET、IGBT、SiC及功率模块的封装需求，订单量增加，2025年一季度收入同比增长236.78%。</p> <p>Q2、2025年二季度业绩趋势？</p> <p>答：从目前来看，公司上半年业务整体保持增长趋势。半导体封装材料业务延续增长，毛率相对较高的智能卡一站式服务订单同比增长。</p> <p>Q3、公司新推出的2025年员工持股计划公司业绩考核目标设定依据？全年增长能否达到考核目标？</p>

答：2025 年员工持股计划公司业绩考核指标为净利润增长率和营业收入增长率均不低于 16%，业绩考核目标设定是基于公司历史财务表现及业务发展规划综合设定的。2025 年公司以业绩考核目标为导向，从今年上半年来看，公司将延续增长趋势，具体为以下几方面：

（1）智能卡方面，深化国内运营商合作，拓展超级 SIM 卡应用场景；

（2）加大半导体封装材料的市场拓展力度，积极向头部功率模块及工装企业推广铜针式散热底板产品；

（3）公司液冷与封装材料产品具备结构创新和成本优势，随着客户的导入及量产计划推进，有望在核心客户放量下实现快速成长。

公司将全力以赴推进各项业务开展，努力实现业绩增长目标。本次业绩考核目标设定具备合理性，但未来实际进展仍需结合市场动态，具体财务情况以后续披露定期报告为准。

Q4、半导体封装材料业务的核心客户、竞争格局、技术壁垒及具体应用环节？

答：（1）客户情况：目前公司主要客户为国内知名的功率半导体封装企业。随着公司产品能力不断增强和市场认可的逐步提升，客户群显著增多，依托全球化战略布局优势，正逐步向海外大型封装集团拓展。

（2）竞争格局：

全球半导体封装材料市场目前由国际巨头主导，同时中国企业正加速追赶，半导体封装材料细分领域呈现差异化竞争，不同客户群体的产品毛利率存在差异。在第三代半导体、车规级功率模块、先进封装等领域，国产化替代进程持续提速。伴随着新能源汽车、光伏储能、智能制造及 AI 计算等高增长下游需求驱动，市场对高性能、高可靠性封装材料的需求持续提升。

（3）技术壁垒：半导体封装材料业务技术壁垒较高，主要体现在材料性能（导热性、延展性、热膨胀匹配）；表面处理质量（电镀均匀性、键合可靠性）；模具与工艺精度（高密度精细图形加工能力）；批量交付稳定性及成本控制能力；对于 IGBT、SiC 功率模块、智能功率模块（IPM）等产品，对封装材料的热性能与抗电迁移能力要求更高。

公司在材料性能优化、规模效率提升及综合成本控制等方面构建形成综合壁垒。

(4) 具体应用环节：主要应用于功率半导体器件及模块的封装环节，具体可覆盖 MOSFET、IGBT、SiC 等 IGBT 功率模块的封装材料供应。目前正积极向头部功率模块及工装企业推广铜针式散热底板产品，适配新能源汽车、光伏逆变器等领域。

Q5、智能卡业务的成长空间及竞争地位、资质要求？

答：(1) 成长空间：智能卡作为信息化基础设施的重要组成部分，广泛应用于金融支付、移动通信、公共交通、安全认证等多个领域。近年来，全球智能卡市场保持稳定增长，但受制于传统应用饱和，整体增长空间逐渐趋于有限。然而，随着工业互联网、AIoT、eSIM（贴片式）等新兴场景快速发展，智能卡产品在新领域中的应用需求不断增长，正在为行业注入新的增长动能，是未来智能卡市场的核心增长动力。面对行业挑战，公司正积极向超级 SIM 卡领域转型，依托在功能集成、数据安全、增值服务等方面的优势，寻求突破传统智能卡业务瓶颈。超级 SIM 卡有望提升单卡附加值，开拓更广阔的市场空间，助力公司智能卡业务进入价值升级。

(2) 竞争地位：公司是国内较早进入智能卡领域的企业，率先构建了从芯片应用研发、模块封测、智能卡研发、生产、销售及终端应用开发的端到端全流程体系，实现了行业内智能卡一站式交付能力的率先突破，提升了产品一致性和交付效率，显著提高了技术门槛与客户粘性，在智能卡行业中具备差异化竞争优势与更高的附加值空间。公司与国际头部企业如 THALES、IDEMIA 建立长期合作关系，产品外销占比超过 60%，并在印度新德里和印尼雅加达设有本地化研发生产基地，具有成熟的海外市场管理与交付经验，是国内智能卡企业中较早实现全球布局的公司。公司主要产品通信智能卡产品销售在全球市场中占有一定比重。

(3) 资质情况：智能卡产品涉及最终客户的信息保密和财产安全，须通过严格的认证方可取得业务资质，相关资质是进入行业的基本前

提，是制卡企业获取更多市场份额的基础。公司按照国际标准、国家标准、行业标准、发卡机构标准及客户标准建立安全生产环境。凭借技术、质量和先进管理等优势，公司获得了 Visa、MasterCard、AMEX、GSMA SAS-UP、IAFT 16949、ISCCC EAL5+、SOGIS CC EAL5+集成电路等多项国内外客户的行业资质认证。

Q6、公司液冷技术的应用领域、技术优势、目前进展产能规划及市场规模与发展空间？

答：（1）应用领域：公司液冷业务聚焦于 AI 服务器、高性能计算液冷系统中的核心热交换部件——液冷板套件，主要包括液冷板主体、分水器、快接组件及辅助密封件等。公司液冷产品主要应用于 AI 服务器、高性能计算等对散热性能要求极高的场景，并正向储能系统、新能源汽车等领域拓展。其优势在于散热效率高、能耗低，关键技术挑战包括系统密封性、导热效率、材料兼容性等。公司已建立液冷产品核心制造和验证体系，具备从结构设计、材料选型到系统集成的技术能力，并持续推进在多元场景下的工程化应用。

（2）技术优势：公司液冷散热产品采用自研的高性能制造工艺，在结构一体化、导热效率与耐压性能方面具备明显性能优势。与传统工艺相比，产品生产效率更高、制造成本更低，能够满足高功耗计算设备对散热性能的严格要求。

（3）目前进展：目前相关产品已完成多轮技术验证，并顺利通过部分客户的样品测试认证，正加速首批样品交付并推进量产准备，当前产能可满足样品及初期订单需求，后续计划结合客户量产节奏，稳步推进液冷板的规模化交付，同时持续优化制程良率与成本结构，加强与高等院校的合作，进行液冷领域人才梯队建设，致力于在下一阶段大规模采购中，实现核心客户的正式量产导入。

（4）市场规模与发展空间：随着 AI 服务器、高性能计算和数据中心等领域的对散热系统的性能需求日益增长，液冷散热技术逐渐成为行业发展的主流方向。液冷模块的单体价值不断攀升，系统级液冷解决方案预计将成为未来服务器整机制造商之间竞争的关键因素；公司专

注于液冷产品领域，该产品线正处于高速增长的赛道。凭借在技术上的独特优势，市场前景极为广阔，未来公司将围绕核心客户，不断推进技术革新、产品个性化定制以及应用领域的拓展。公司将致力于以“技术领先、快速响应和规模化交付能力”为核心竞争力，力争在下一代高性能散热技术中占据稳定的市场份额，并推动液冷业务成为公司新的增长点。

Q7、公司液冷产品在客户供应链的地位如何？如何保持？客户对成本和工艺的考量情况怎样？

答：液冷产品作为 AI 服务器、高性能计算设备等核心散热系统中的关键热交换部件，其导入需经过较长周期的技术验证和多轮样品测试，一旦进入客户体系，具有较强的技术绑定性与粘性。公司当前产品在多个关键结构件中具备自主工艺优势，制造成本和热控效率表现良好，已获得部分客户在成本效益与技术成熟度方面的积极认可。公司已完成相关产权与产能储备，可支持后续批量交付。同时，通过协同开发、工程驻场、定制化接口设计等方式提升客户粘性，公司也在同步推进下一代液冷产品的预研工作，围绕更高热通量、更低能耗、更复杂结构的热管理需求，布局先进材料、复合结构设计及智能热控等方向，提升产品的技术前瞻性和客户粘性，为未来在多行业中的拓展奠定基础并在新项目中实现更多结构占比提升。

Q8、智慧安全业务安全防护栏项目的应用场景、商业模式价值量？

答：公司安全防护栏项目主要应用于高铁站台场景，通过智能化物理隔离方案有效提升旅客安全防护水平，满足铁路系统对安全防护升级的需求，公司推出新一代安全防护栏，经过多轮技术迭代，该产品在安全性与防夹伤性能上实现了显著提升。

商业模式采用按站台长度计价的方式，并根据具体防护等级需求提供差异化浮动方案。近年来公司积极投入该项目的市场推广，并与相关部门紧密协作，共同推进试验线建设。因项目具备较高的技术门槛与安全防护需求属性，其附加值潜力可观。随着各地站点招标工作的逐步开展，该业务不仅有助于进一步巩固公司在智慧交通安全领域的战

	<p>略布局，还将为公司开辟新的业绩增长点。</p> <p>Q9、公司四大主营业务版块之间的发展历程？协同性如何？</p> <p>答：公司四大业务的发展历程始于智能卡芯片封装的核心工艺能力。基于这一技术基础，公司逐步向半导体封装材料领域延伸，开发出引线框架及散热底板等产品，广泛应用于功率半导体封装；进一步地，公司依托散热底板的技术积累及客户群体需求的深刻理解，衍生出液冷系统解决方案，服务于服务器、新能源汽车等高热管理场景。智慧安全业务独立聚焦交通场景创新，包括多年智能卡行业的技术沉淀，拓展到超级 SIM 卡应用场景。</p> <p>公司业务的整体协同性体现在以材料与结构设计能力为纽带，实现了从智能卡向半导体封装材料、液冷技术的跨领域延展，形成“工艺-材料-系统”的技术闭环。</p> <p>Q10：未来是否考虑并购？</p> <p>答：公司坚持稳健经营策略，在发展上，公司不一味追求速度和规模，更注重稳健和长效。公司也密切关注产业链上下游优质标的，对行业内并购机会保持持续关注，公司将在充分评估风险和收益的前提下，结合行情变化及公司发展需求谨慎决策并适时考虑。</p>
<p>风险提示</p>	<p>公司提醒新业务新产品开发过程中存在一定的技术风险、市场风险和应用验证周期风险，上述内容如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关信息，不视作公司或公司管理层对行业、公司发展的承诺与保证，公司将严格按照有关法律法规的要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2025-6-18</p>